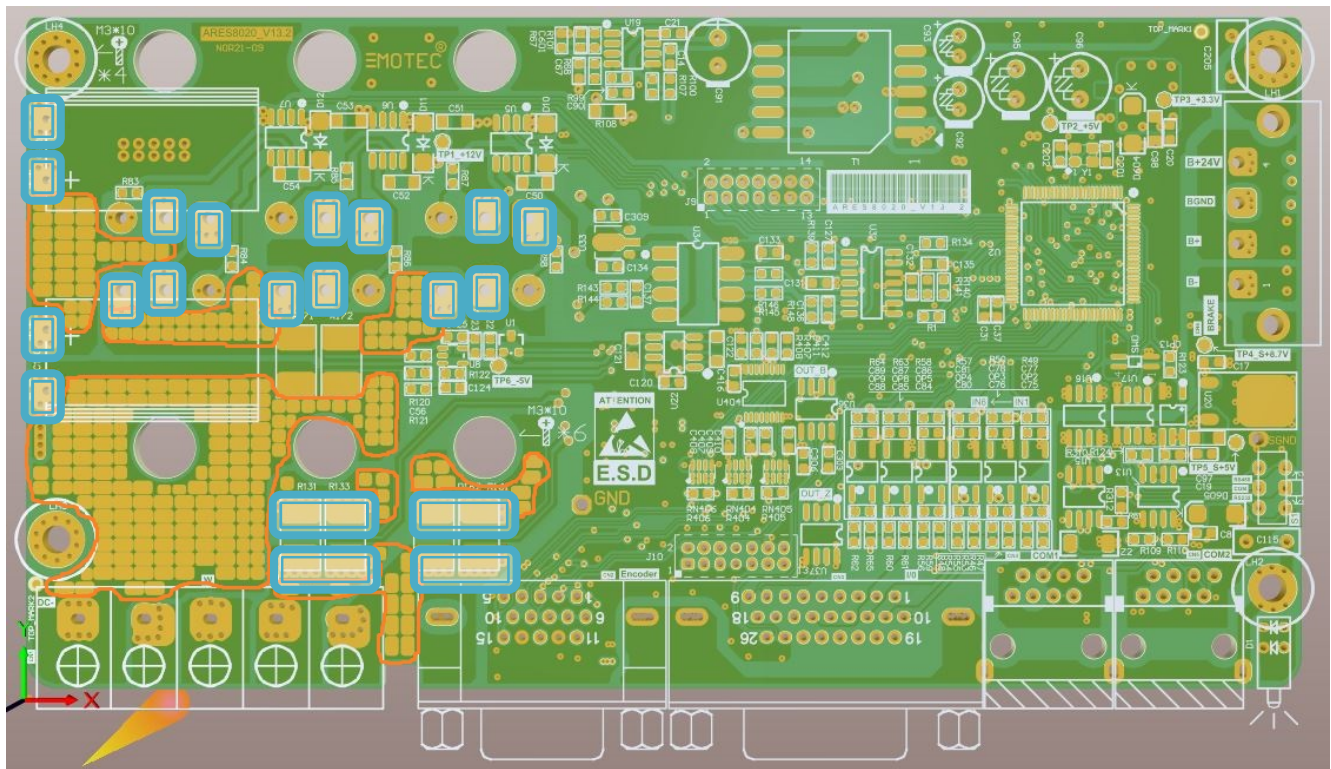




PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8020N_V2	焊接	QM03321220329	V2	1/2	20220329

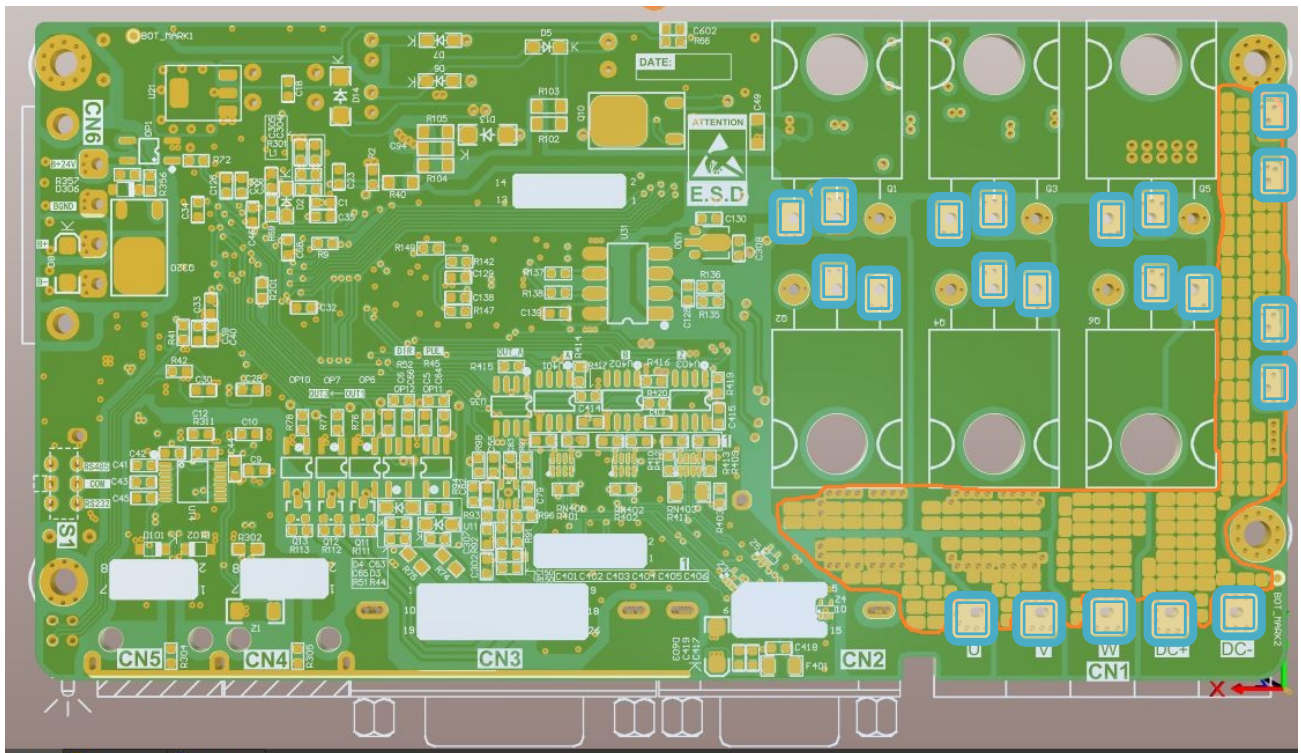
1. ARES8020N_V2 加锡位置



顶层



- 1)  橙色框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm；
- 2)  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内上下焊锡通透（灌满焊锡）；

底层



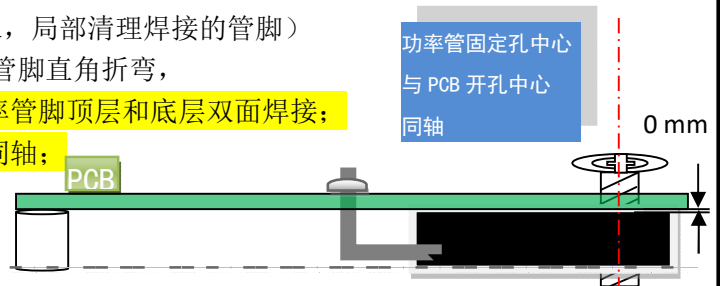
- 1)  橙色框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm；
- 2)  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡；
- 3) CN1 端子，底层加锡焊接，焊锡熔化后，电烙铁仍要停留 2~3 秒，保证焊锡从过孔完全流到板子顶层。

PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8020N_V2	焊接	QM03321220329	V2	2/2	20220329

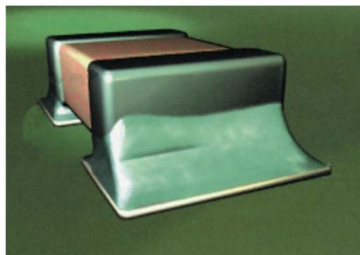
2. 焊接基本要求

- 1) 滑动开关 S1, 洗板时, 不要进入液体, 否则会影响使用
(或者在洗完板后焊接 S1, 之后用小刷子沾洗板水, 局部清理焊接的管脚)
- 2) 功率管 Q1~Q6 共计 6 个 (T0-247 封装的管子), 管脚直角折弯,

- a) 有型号标识的面紧贴线路板焊接, 且要求功率管脚顶层和底层双面焊接;
- b) 焊接后, 功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴;

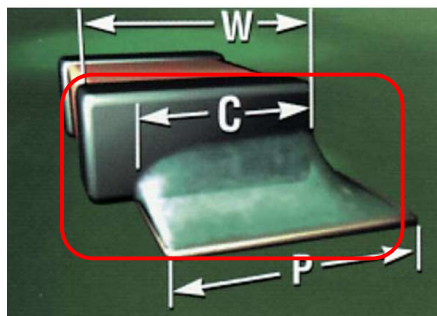


- 3) 电阻 R131, R133, R161, R162, R171, R172 要求焊接完成后, 保证元件不偏移, 见下图 (元件的电极与相应焊盘位置重叠)



目标 - 1, 2, 3 级
 • 末端连接宽度等于元器件端子宽度或焊盘宽度, 取两者中的较小者。

- 可接受: a) 端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 5% (约 0.15mm, 下图为焊接不良图片)。
- b) 端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿



备注: 该位置要求 100% 目检, 不符合要求的, 拒收!

- 4) 从底层焊接面焊接 CN1 黑色栅栏端子, 焊锡要透到顶层元件面;
- 5) 电解电容 C100 和 C101:
 - A) 按照丝印标识折弯管脚, 卧式贴线路板焊接, 注意两个电解折弯方向相反;
 - B) C100 和 C101 电解电容与 PCB 接触面涂覆 704 黑色固定胶, 点胶不要过量;
- 6) 变压器 T1 焊接前, 要对管脚的平整度进行调整, 避免出现管脚虚焊和变压器焊接后, 不在同一平面上;
- 7) 所有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 8) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 9) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 10) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 11) 手工操作要做防静电处理;
- 12) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;
- 13) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	